附件1

报名回执

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 参会人员 | | | |
| 姓名 | 职 务 | 联系电话 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 参加活动 | □开幕式暨主旨论坛 （11月15日上午）  **以下活动在11月15日下午并行举行，请选择参加**  □分论坛：信息通讯技术创新论坛  □分论坛：产学研国际协同创新论坛  □分论坛：第三代半导体高峰论坛  □项目路演及产融对接活动 | | |

注：报名截止日期：11月10日（星期二），请尽快将填好的报名回执发至电子邮箱510452030@qq.com。

联系人：苏毅贤 ，联系电话：13651439255